

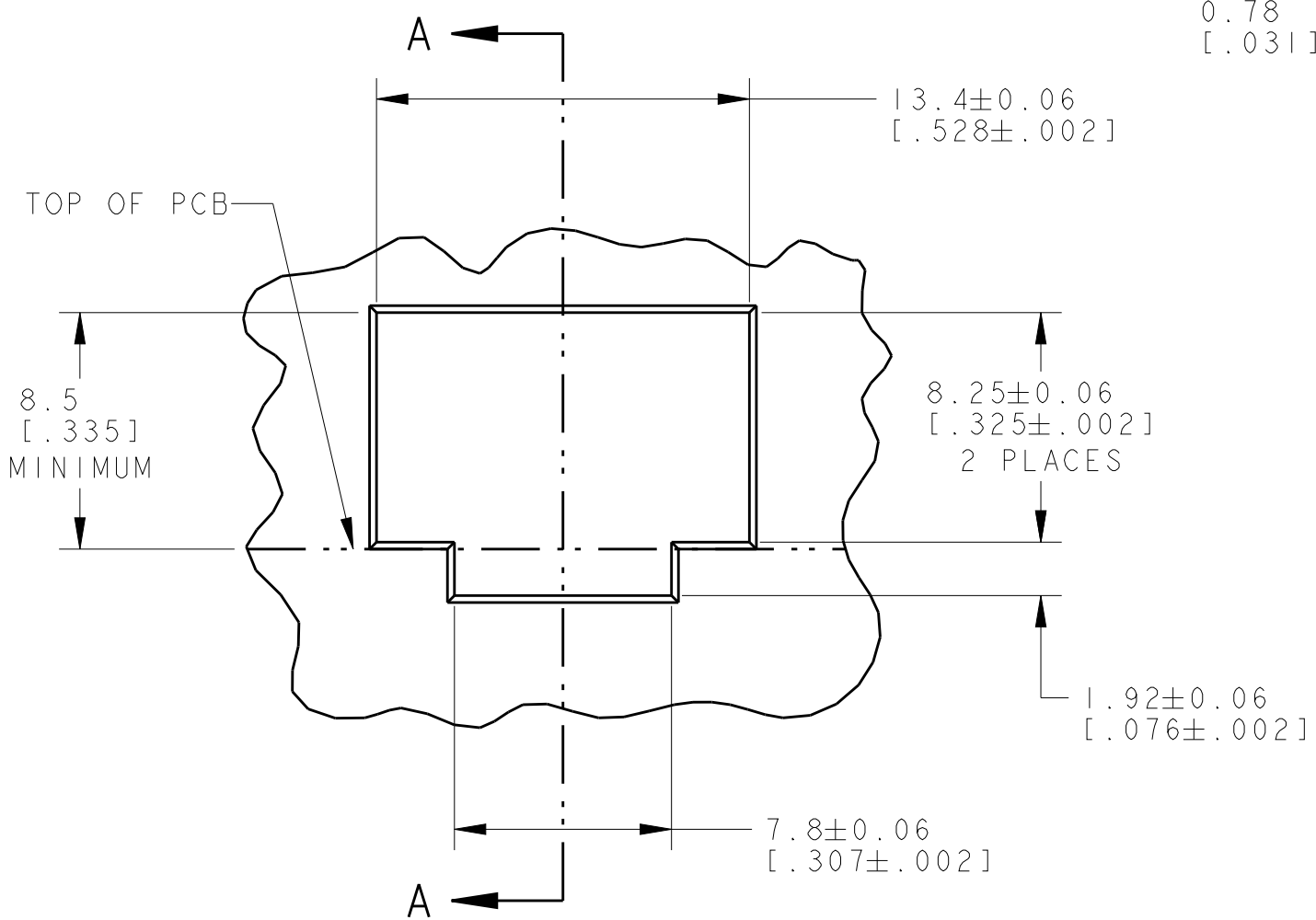
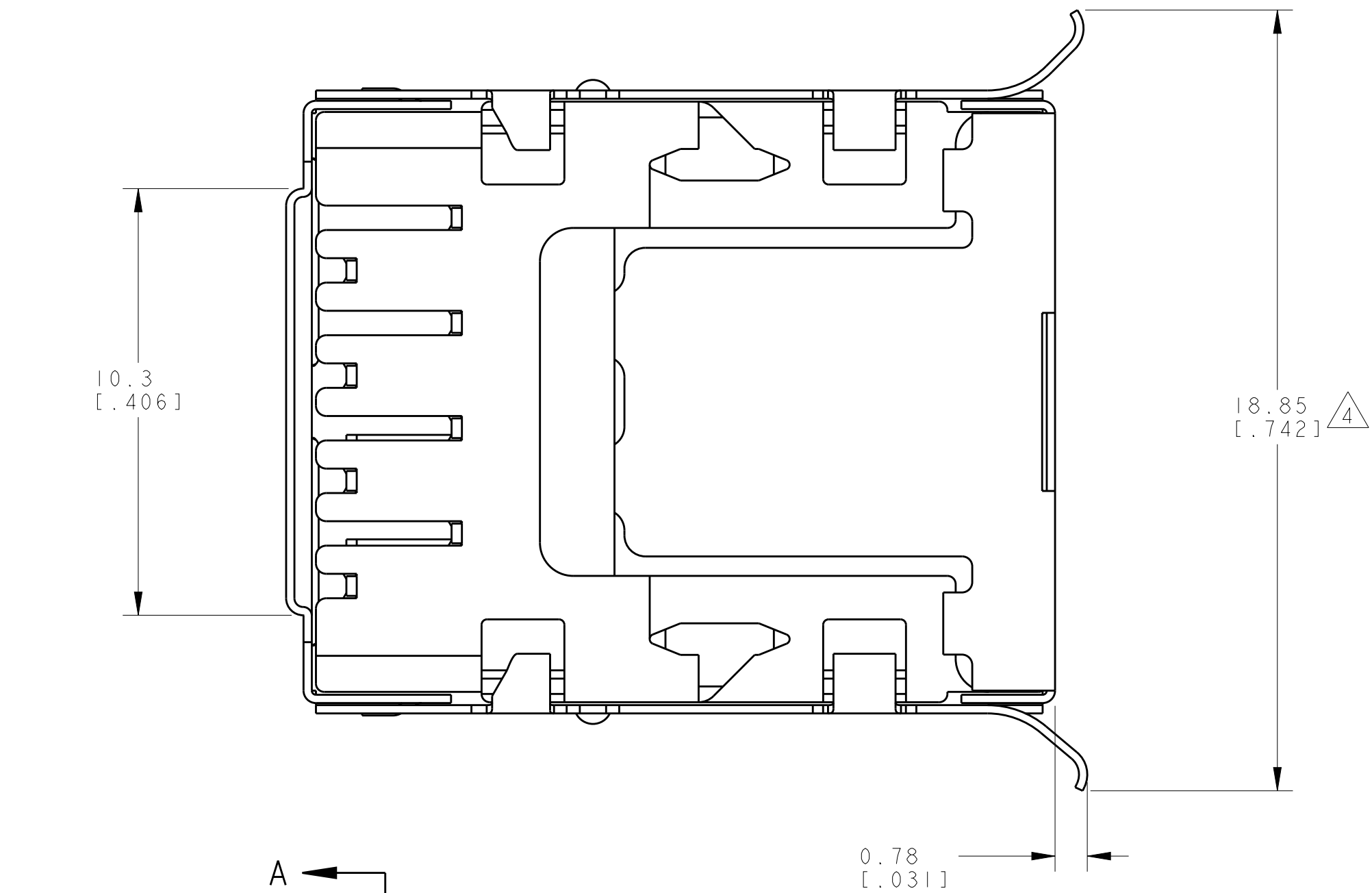
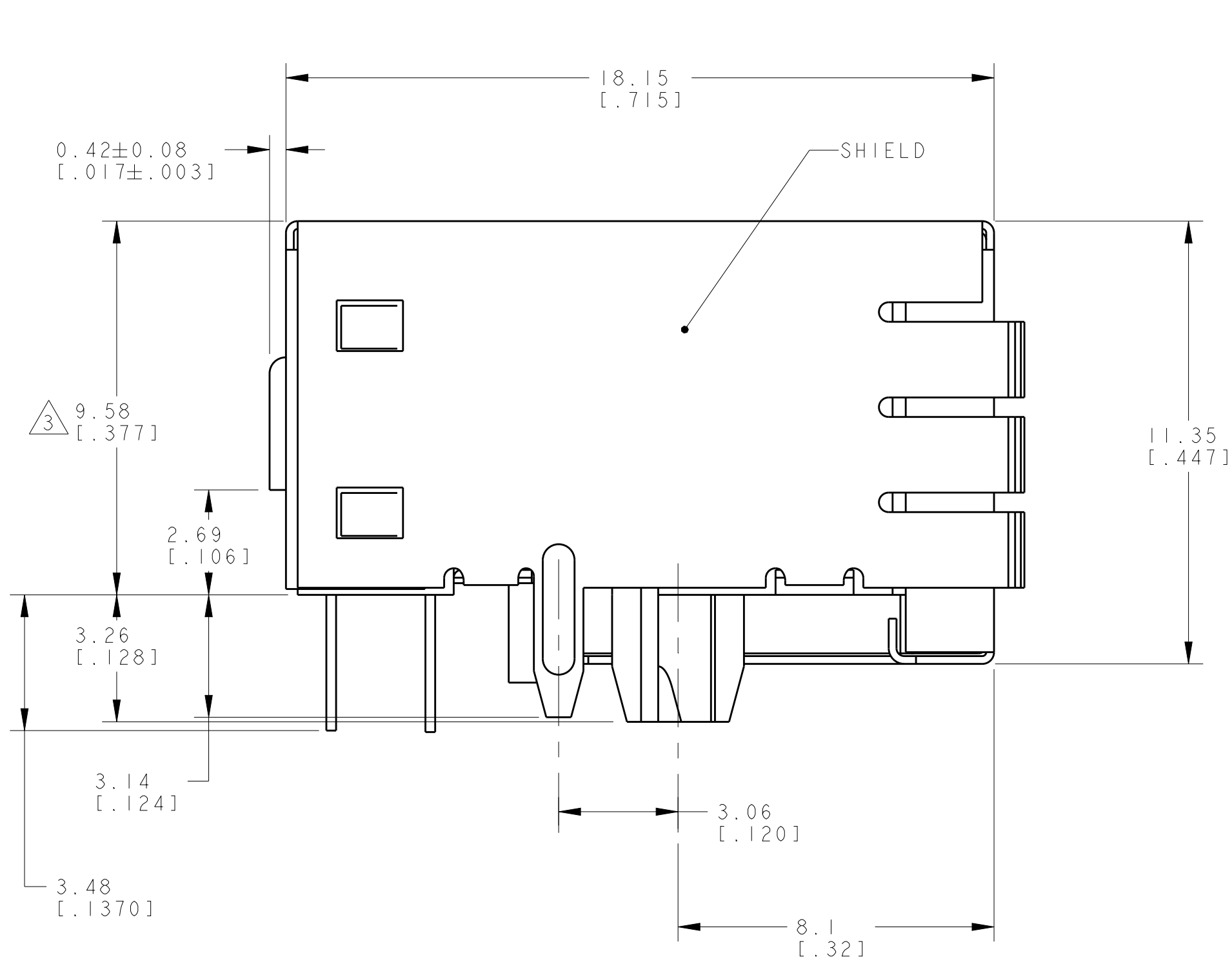
REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECO-14-015233	27APR2015	LL	SH

D

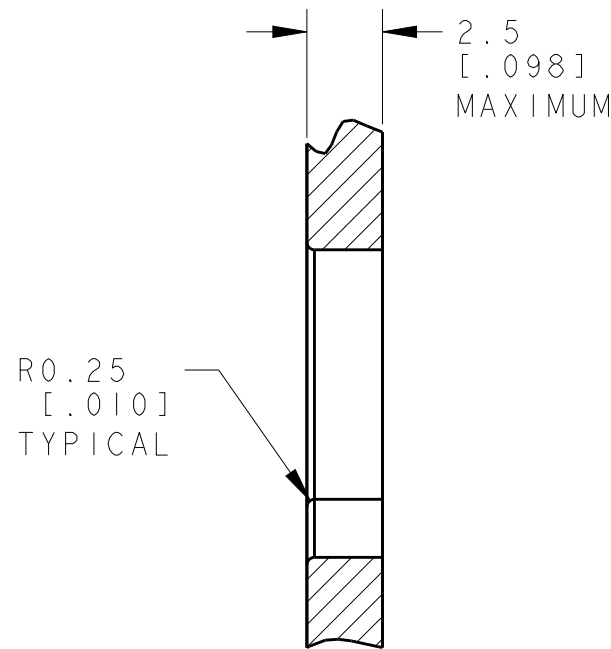
C

B

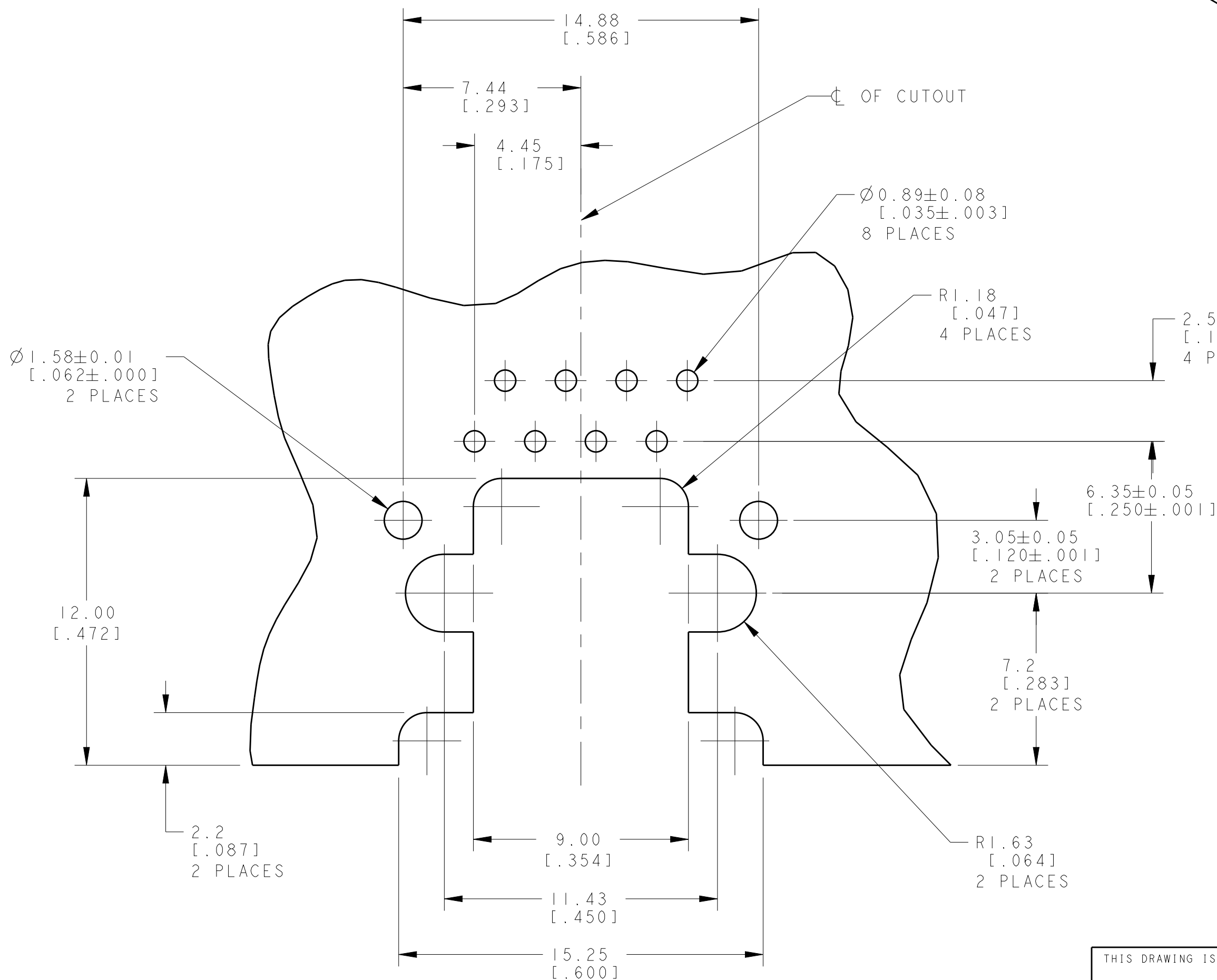
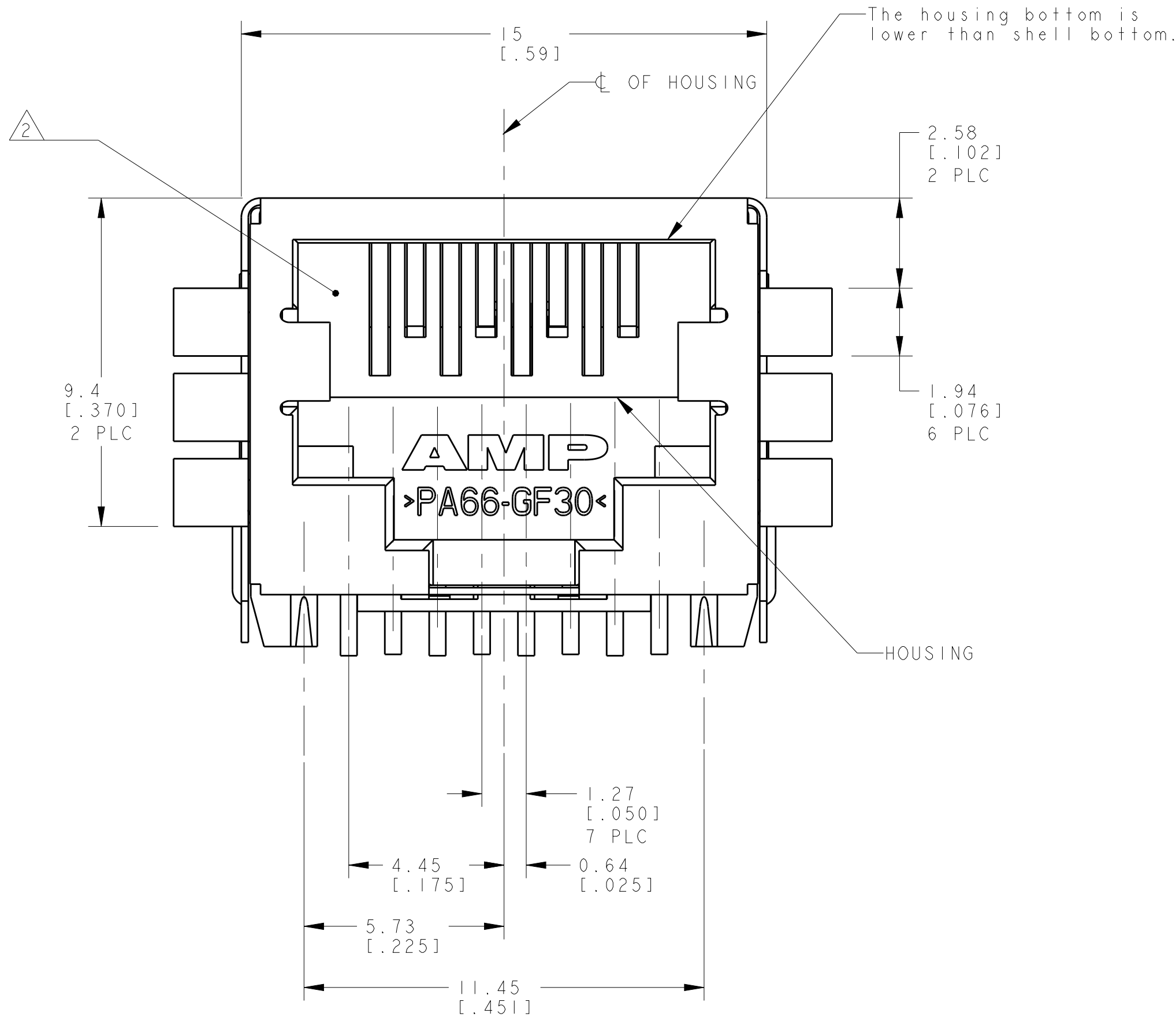
A



SUGGESTED PANEL CUTOUT
SCALE 4:1

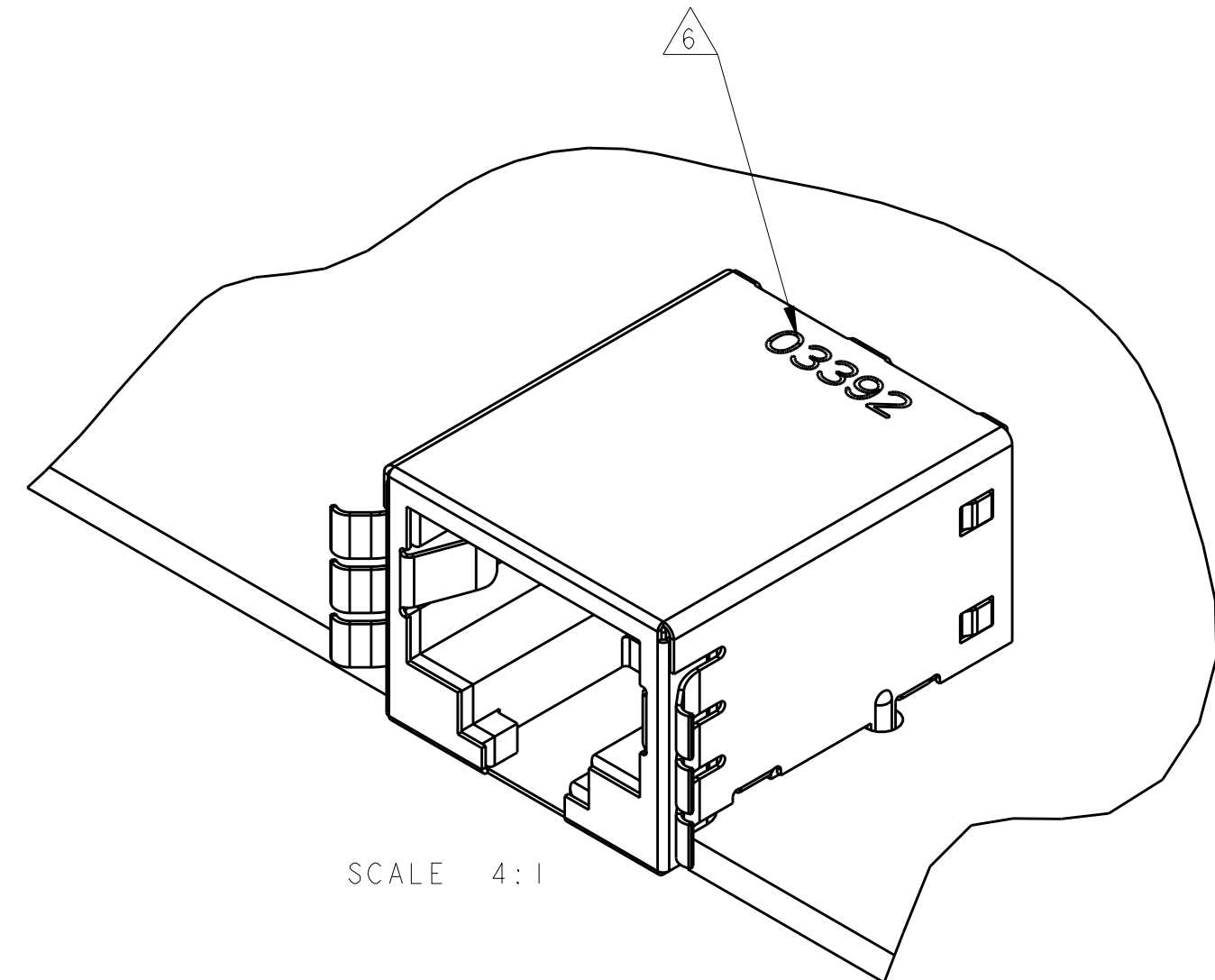


SECTION A-A

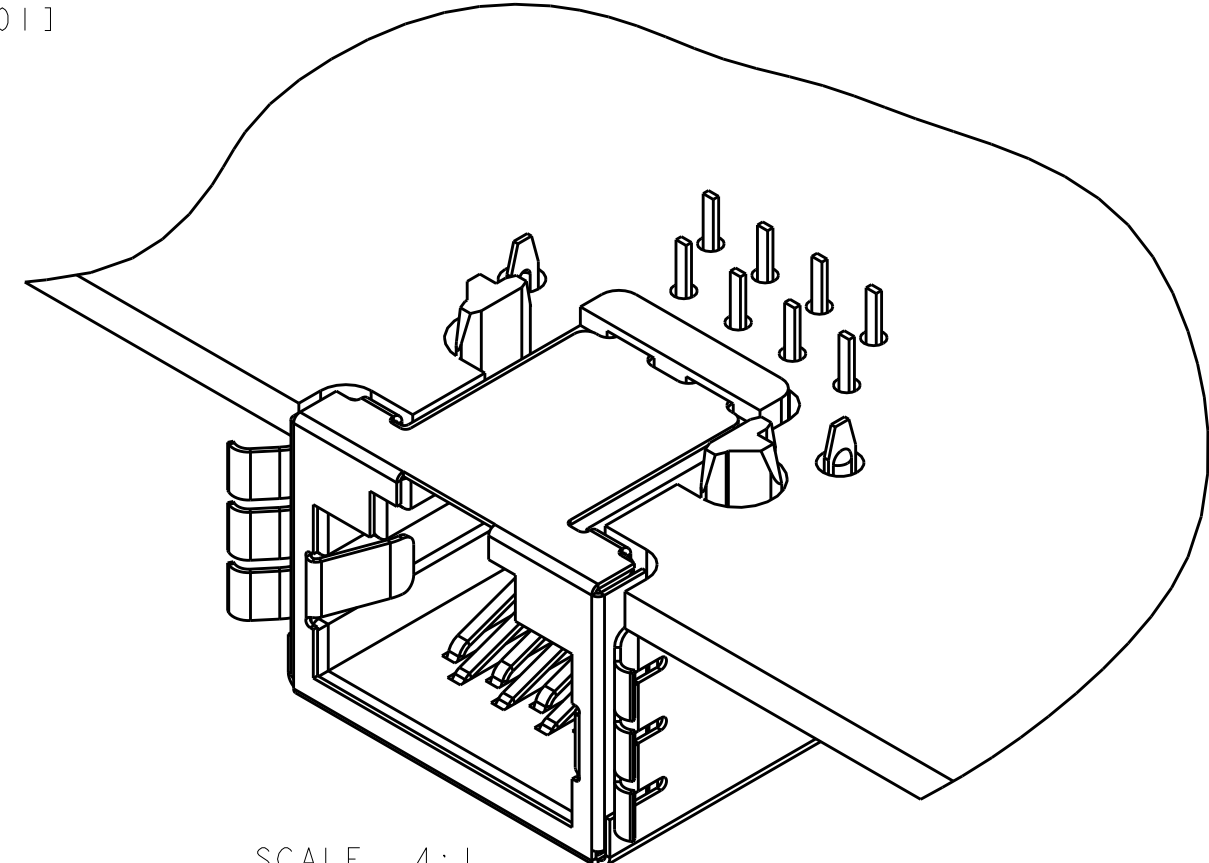


SUGGESTED PRINTED CIRCUIT
BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE
SCALE 6:1

- 1 MATERIAL: HOUSING - HIGH TEMPERATURE NYLON, BLACK, UL 94V-0, IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE. TERMINALS - 0.25[.010] THICK PHOSPHOR BRONZE PLATED WITH 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA, 1.27µm[.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27µm[.000050] MINIMUM THICK NICKEL. SHIELD - 0.1[.0039] MIN THICK COPPER ZINC ALLOY, PREPLATED WITH 2.0-4.0µm (.000079-.000157) THICK TIN OVER 1.27µm (.000050) MIN THICK NICKEL.
- 2 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- 3 THIS DIMENSION REPRESENTS THE TOTAL HEIGHT OF THE CONNECTOR FROM THE TOP OF THE PC BOARD.
- 4 THIS DIMENSION HAS A MAXIMUM VALUE OF 20.50[.807] WHEN JACK IS INSTALLED BEHIND PANEL.
- 5 PACKAGED 66 ASSEMBLIES PER PVC TRAY, 396 PER BOX.
- 6 MANUFACTURING DATE CODE: ORIENTED AND LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN. LASER PRINTING. TEXT HEIGHT APPROXIMATELY 2MM. FIRST 2 DIGITS = LAST 2 DIGITS OF YEAR NEXT 2 DIGITS = MANUFACTURING WORK WEEK LAST DIGIT = DAY OF WEEK WITH SUNDAY = 1



SCALE 4:1



SCALE 4:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN KINSEN, SUN 28MAY2010	1932626-1	
DIMENSIONS: mm[INCHES]		CHK SUNY, ZHAO 28MAY2010	MATERIAL/ FINISH	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD STEVEN, YAO 28MAY2010	PART NUMBER	
0 PLC ±		PRODUCT SPEC	TE Connectivity	
1 PLC ±		108-1163	MODULAR JACK ASSEMBLY, 8 POSITION, SHIELDED, 10mm	
2 PLC ±		APPLICATION SPEC	-	
3 PLC ±		114-2048	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
4 PLC ±		114-2048	RESTRICTED TO	
ANGLES ±		114-2048	-	
FINISH		114-2048	-	
MATERIAL SEE P/N TABLE		WEIGHT 3.49 grams	A1	
SEE P/N TABLE		CUSTOMER DRAWING	C=1932626	
			SCALE 8:1 SHEET 1 OF 1 REV B	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9